



## Technische Web(-Sem)inare

### *Überprüfung der Signalintegrität / EMV für PCI-Express / DDR2 / RocketIO / StratixGX*

Neue Technologien wie **PCI-Express, DDR2, RocketIO, StratixGX, SATA** etc. mit Bandbreiten im Gbps-Bereich erfordern neue Methoden und exaktere Modellierungen der Leiterbahnen auf der Baugruppe, um genaue Analysen zur **Signalintegrität** und **elektromagnetischen Verträglichkeit** durchführen zu können. Dies ist darin begründet, dass bei den mit diesen Technologien angewendeten Frequenzen, Effekte mit berücksichtigt werden müssen, die in den bisherigen Technologien vernachlässigbar waren, jetzt aber signifikant das Signal auf der Leiterbahn stören.

Lassen Sie diese Effekte unberücksichtigt, dann wächst die Wahrscheinlichkeit von **Redesigns** Ihrer Baugruppen dramatisch an, was eine verzögerte Markteinführung Ihrer Produkte und höhere Entwicklungskosten bedeutet. Bedenken Sie nur, dass Ihr empirisches Wissen mit der nächsten Technologiegeneration möglicherweise diese neue Klasse von Effekten nicht berücksichtigt!

Unsere in deutscher Sprachen gehaltene, technisch orientierte Web(sem)inar Reihe stellt die technologischen Herausforderungen vor und erläutert, wie erste Analysen vor Layout durchgeführt werden können, deren Ergebnisse schon als Vorgaben für das Design der Baugruppe dienen.

**Themen - bitte geben Sie noch Ihren Terminwunsch an:**

#### **Herausforderungen von PCI-Express**

[mailto:marion.camphausen@trias-mikro.de?subject=Webinar\\_HLX\\_PCI\\_Express](mailto:marion.camphausen@trias-mikro.de?subject=Webinar_HLX_PCI_Express)

#### **Herausforderungen von DDR2**

[mailto:marion.camphausen@trias-mikro.de?subject=Webinar\\_HLX\\_DDR2](mailto:marion.camphausen@trias-mikro.de?subject=Webinar_HLX_DDR2)

#### **Herausforderungen von RocketIO / StratixGX**

[mailto:marion.camphausen@trias-mikro.de?subject=Webinar\\_HLX\\_RocketIO\\_StratixGX](mailto:marion.camphausen@trias-mikro.de?subject=Webinar_HLX_RocketIO_StratixGX)

#### **Herausforderungen von SATA**

[mailto:marion.camphausen@trias-mikro.de?subject=Webinar\\_HLX\\_SATA](mailto:marion.camphausen@trias-mikro.de?subject=Webinar_HLX_SATA)

#### **Registrierung:**

Bitte melden Sie sich bitte bis spätestens 2 Tage vor der Veranstaltung an. Zur Anmeldung **klicken** Sie bitte auf die angegebenen Links und geben in der Email Ihre kompletten Kontaktdaten und Ihren **Wunschtermin** an.

Zur Teilnahme benötigen Sie nur einen Internetzugang sowie ein Telefon. Die Zugangsdaten und Telefonnummer erhalten Sie zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung.